

芯联集成电路制造股份有限公司 2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度营业收入约为 53.25 亿元，与上年同期相比增加约 7.19 亿元，同比增长约 15.60%。预计 2023 年度主营业务收入约为 49.04 亿元，与上年同期相比增加约 9.45 亿元，同比增长约 23.88%。
- 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-19.50 亿元，与上年同期相比将增亏约 8.62 亿元。
- 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-22.92 亿元，与上年同期相比将增亏约 8.89 亿元。
- 公司预计 2023 年度 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 9.37 亿元，与上年同期相比增加约 1.27 亿元，同比增长约 15.66%。
- 公司预计 2023 年度经营性净现金流约为 25.18 亿元，与上年同期相比增加约 11.84 亿元，同比增长约 88.75%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“报告期”）。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年度营业收入约为53.25亿元，与上年同期相比增加约7.19亿元，同比增长约15.60%。预计2023年度主营业务收入约为49.04亿元，与上年同期相比增加约9.45亿元，同比增长约23.88%。

2、公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-19.50亿元，与上年同期相比，将增亏约8.62亿元。

3、公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-22.92亿元，与上年同期相比将增亏约8.89亿元。

4、公司预计2023年度EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为9.37亿元，与上年同期相比增加约1.27亿元，同比增长约15.66%。

5、公司预计2023年度经营性净现金流约为25.18亿元，与上年同期相比增加约11.84亿元，同比增长约88.75%。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度：

营业收入：46.06亿元。

主营业务收入：39.58亿元。

归属于母公司所有者的净利润：-10.88亿元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14.03亿元。

EBITDA（息税折旧摊销前利润）：8.10亿元。

经营性净现金流：13.34亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务的影响：报告期内，随着全球新能源汽车市场的持续繁荣以及国产替代需求的提升，公司在高端车载产品领域采取“技术+市场”双重保障机制，促使公司整体收入的高速增长和经营性净现金流的大幅提升。截至报告期期末，公司拥有种类完整、技术先进的高质量功率半导体研发及量产平台，已成为国内规模最大的 MEMS 传感器芯片，车规级 IGBT 芯片、SiC MOSFET 芯片及模组封测等的代工企业。

（二）研发投入的影响：报告期内，为保证产品具有国际竞争力，公司持续在 8 英寸功率半导体、MEMS、连接等方向增加研发投入，同时公司大幅增加了 SiC MOSFET、12 英寸产品方向的研究力度。预计 2023 年研发支出约 15.13 亿元，研发投入约占营业总收入的 28%，同比增加约 6.74 亿元，同比增长约 80%。2023 年，公司共提出知识产权申请 295 项，获得专利 102 项。上述新研发项目和知识产权积累为公司未来的发展和收入增长奠定了基础。

（三）扩产项目影响：报告期内，公司在 12 英寸产线、SiC MOSFET 产线、模组封测产线等方面进行了大量的战略规划和项目布局。2023 年度公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 101.00 亿元，报告期内，公司预计产生的折旧及摊销费用约为 34.71 亿元，较上年增加约 13.90 亿元。上述事项的前期费用和固定成本，对公司报告期内的经营业绩产生了较大影响。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2023 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 9.37 亿元，与上年同期相比增加约 1.27 亿元，同比增长约 15.66%。随着新增产能的逐步释放，收入水平的快速提升，规模效应逐步显现，以及折旧的逐步消化，公

公司在业务布局、技术的领先性以及产品结构等方向的优势将逐渐显现，盈利能力将得到快速改善。

面向未来，公司持续看好汽车电动化、智能化进程，随着新产品、新应用、新客户的拓展，预计公司车规级产品营业收入将持续增加，特别是 SiC MOSFET 上车速度与数量将快速提升，公司最新一代的 SiC MOSFET 产品性能已达世界领先水平，正在建设的国内第一条 8 英寸 SiC 器件研发产线将于 2024 年通线，同时将与多家新能源汽车主机厂签订合作协议，2024 年 SiC 业务营收预计将超过 10 亿元，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封测领域的领先地位。

公司已经完整搭建了覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平台，客户群广泛覆盖国内外的领先的芯片和系统设计公司。随着公司产品研发创新以及 SiC MOSFET 产线、12 英寸产线、以及模组封测产线产能的不断释放，将持续不断地提升对公司 2024 年营业收入的贡献。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2023年1月31日